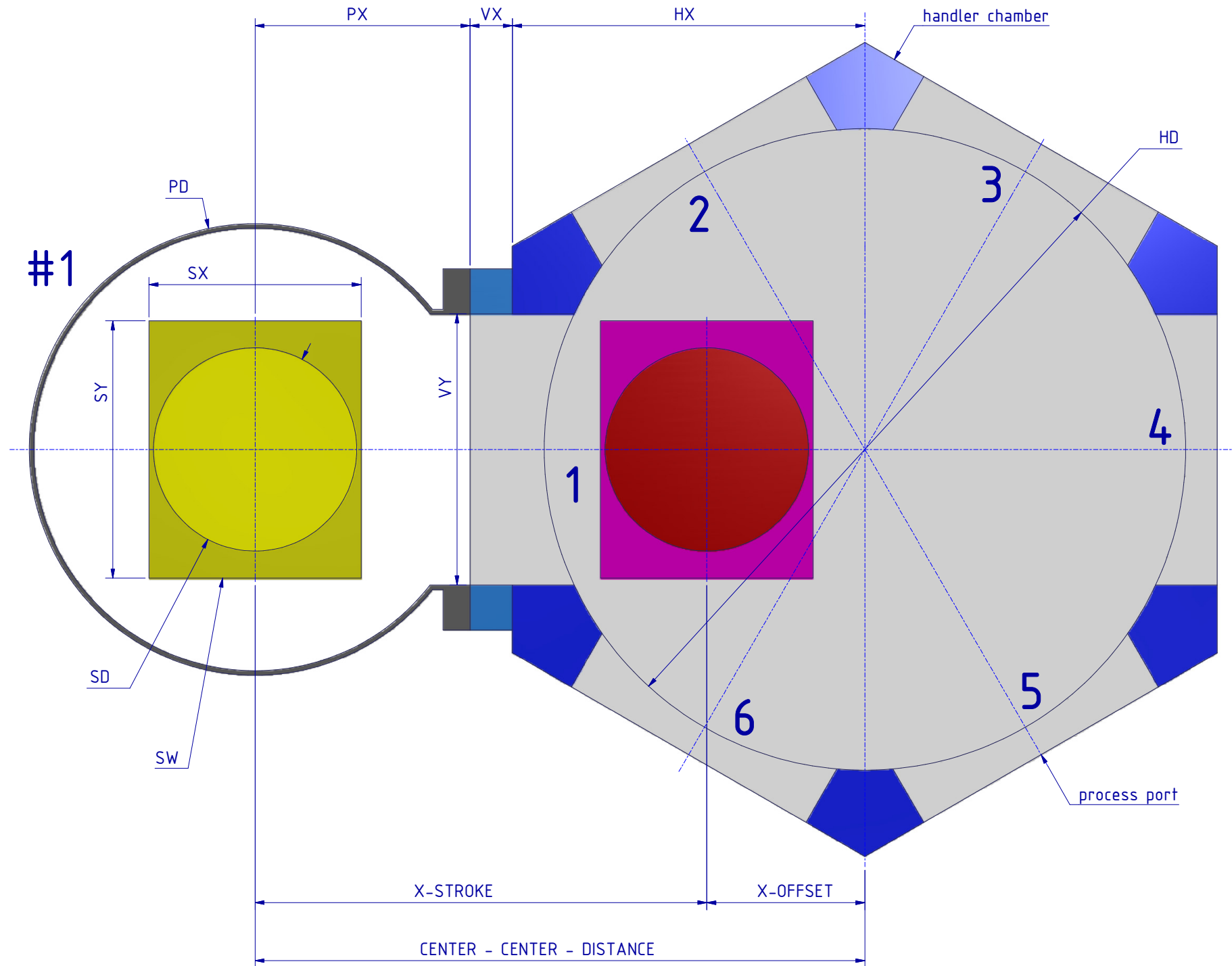


HANDLING CHAMBER

PROCESS #1



MINIMUM REQUIRED DIMENSIONS:

Substrate dimensions:

- rectangular: SX and SY
- circular: SD
- substrate/carrier weight (LOAD): SW

Process dimensions:

- quantity of process stations, e.g. 4 or 6 pcs. of process ports
- PX = sealing surface process chamber to center of process chamber

Valve dimensions:

- VX = valve thickness
- VY = valve width (opening)
- VZ = valva high (opening)

Additional dimensions (if available):

- PD = dimensions of process chamber

Informal dimensions (tbd):

- HX = sealing surface handling chamber to center of handling chamber
- HD = inner diameter handling chamber

www.waferhandling.solutions

Positionstoleranz / tolerances of location		Kanten mit unbestimmter Form nach DIN ISO 13715		Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768		Prüfmaße nach DIN 406-T1	
I	Bohrungen / holes	0,1 mm	+0,3 -0,1	Form und Lage	m	Tolerierungsgrundsatz nach ISO 8015	
I	Gewinde / threads	0,1 mm	+0,1 -0,1	Allg.-Tol. Schweißkonst. nach DIN ISO 2768	K	Bewertungsgruppe für Unregelmäßigkeiten (Schweißverbindungen)	
I	Passungen / fits	0,01 mm		Form und Lage	P	DIN EN ISO 5817 c	
projection ISO 128 - method 1		Oberflächenbeschaffenheit nach DIN EN ISO 1302		Maßstab: 1 : 5		Masse: -	
		Vakuum-Dichtflächen keine Rillen und Riefen quer zum Dichtungsverlauf zulässig		Halbzeug:		Material/Oberfläche: Allgemein	
		Dichtfläche Rz 6,3		Benennung		Wafer Handling Robot	
				Datum		Name	
				Gezeichnet		20.09.2015 BC	
				Freigabe			
				Zeichnungsnr.		188-210000-99	
				Revision		00 1 / 1	
				Status		A2	
				Name		151105_188-210000-99.idw	
				Ersatz für:		Ersatz durch:	